



大型卓上リフローはんだ付け装置 RF-330

RF-330は遠赤外線式卓上リフローはんだ付け装置です。10×10mmのH-IC基板から300×300mmの大型SMT基板までコンベアに乗せるだけで、チップ部品からQFPやBGAまで、全ての部品を2～3分でリフローはんだ付けできます。卓上型なので設置場所を選ばず、実験、研究から量産まで全てに対応します。

特長

卓上型で単相200V電源なので設置場所を選びません。

10×10mmのH-IC基板から300×300mmの大型SMT基板までリフローはんだ付けできます。

プリヒート、リフローゾーン共に、デジタルPID温度制御なので安定した温度プロファイルが得られます。

仕様

- ・加熱部 :2ゾーン 幅300mm×長さ620mm 入口高さ25mm
- ヒーター :石英管ヒーター IR (波長:2～10μm)
- プリヒートゾーン 上部:1.2kW 下部:0.9kW
- リフローゾーン 上部:0.9kW 下部:0.6kW
- 加熱方式 :IR+自然対流方式
- 温度制御 :Max300 P.I.D.温度調節器
- 各ゾーン共上部炉内雰囲気温度制御
- ・コンベア :幅300mm SUSメッシュベルト。10～540mm/min
- 方向 :L R
- ・冷却 :出口側ファンによる強制空冷
- ・電源 :単相200V±10% 3.7kW 50/60Hz
- AC220V-EC, AC120V-USもあります。
- ・安全装置 :漏電/過電流ブレーカー
- 非常停止スイッチ。
- ・外形寸法 :(W)1300×(D)500×(H)275mm
- ・重量 :約66kg

適合基板

- 寸法 :15mm×15mm
- ～300mm×300mm
- 板厚 :0.1mm～2mm
- 高さ :MAX25mm

用途

- ・H-ICやSMT基板のリフローはんだ付け。
- ・熱硬化接着剤の乾燥。その他加熱作業。

オプション

- ・動作表示灯

本仕様は予告なく変更することがあります。